

FPC用熱硬化型 導電性ボンディングフィルム

CBF-300 / -W6



CBF-300は、熱硬化型の導電性ボンディングフィルムです。貼り合わせる補強板が金属の場合、FPCのGND回路と電気的な接続を取ることで、金属補強板をシールド層として機能させることが可能です。

特徴

▶ GND強化

FPCのGND回路と金属補強板を電氣的に接続することでGNDを強化

▶ 高導電性

特殊金属フィラーの採用により安定した導電性を実現

▶ リフロー耐性

FPCに補強板を接着した後、鉛フリーハンダリフローによる部品実装が可能

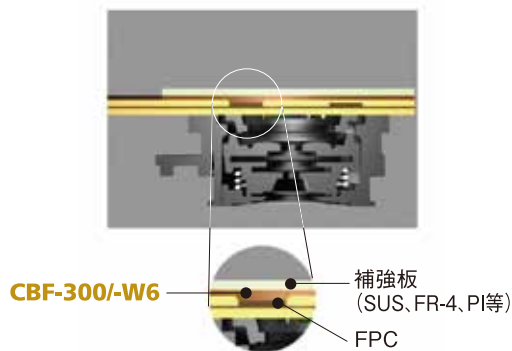
▶ 密着性

SUS、FR-4、PI等の補強板と優れた密着性を実現

環境適合性

| 環境対応 | CBF-300/-W6 |
|---------------|-------------|
| ハロゲンフリー | 適合 |
| RoHS指令 | 適合 |
| 鉛フリーハンダリフロー対応 | 適合 |

応用例：カメラモジュール



FPCのGND回路とSUSを電氣的に接続。
CBFでSUSのハイブリッド化を実現。

CBF-300 / -W6の構成

CBF-300 セパレートフィルム (透明)
CBF-300-W6 セパレートフィルム (白)

